## **RESIN COMPOSITION FOR OPTICAL MATERIAL AND PREPARATION THEREOF**

Patent number:

JP8041303

**Publication date:** 

1996-02-13

Inventor:

IGARASHI MITSUHISA; KUSHIMOTO TOSHIHIRO;

OKAMOTO TANEO; FUJI MICHIAKI; YAO KENJI

**Applicant:** 

KANEBO LTD

Classification:

- international: B29C45/00; C08G63/197; C08J5/00; C08L67/02;

C08L69/00; G11B7/24; B29C45/00; C08G63/00;

C08J5/00; C08L67/00; C08L69/00; G11B7/24; (IPC1-7):

C08G63/197; C08L67/02; B29C45/00; C08J5/00;

C08L69/00; G11B7/24

- european:

Application number: JP19940197301 19940728 Priority number(s): JP19940197301 19940728

Report a data error here

#### Abstract of JP8041303

PURPOSE:To prepare a resin compsn. for an optical material having excellent transparency, moisture resistance, mechanical strength, and dimensional and form stability by blending a particular linear polyester polymer with an arom. polycarbonate. CONSTITUTION:A resin compsn. comprising a homogeneous blend of a linear polyester polymer comprising an arom. dicarboxylic acid or a diester deriv. thereof, a dihydroxy compd. represented by the formula, and a 2-4C aliph. glycol with an arom. polycarbonate. In the formula, R<1> is a 2-4C alkyl; and R<2>, R<3>, R<4>, and R<5> are each H or a 1-4C alkyl. The glass transition temp, of the resin compsn. should be 78 deg.C or above, pref. 80 deg.C or above. A glass transition temp. below 78 deg.C results in, for example, deformation of a substrate during the storage of an optical disk product, thus posing a problem such as occurrence of a noise.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 特 許 公 報 (B 2)

(11)特許番号

特許第3023279号 (P3023279)

(45)発行日 平成12年3月21日(2000.3.21)

(24)登録日 平成12年1月14日(2000.1.14)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		
C08L	67/02		C08L	67/02	
	69/00			69/00	
G11B	7/24	<b>5 2 6</b>	G11B	7/24	5 2 6 S

請求項の数3(全 7 頁)

(21)出願番号	特願平6-197301	(73)特許権者	000000952
(22)出願日	平成6年7月28日(1994.7.28)		館紡株式会社 東京都墨田区墨田五丁目17番4号
		(72)発明者	五十嵐 光永
(65)公開番号	特開平8-41303		大阪市都島区友渕町1丁目6番4-101
(43)公開日	平成8年2月13日(1996.2.13)		号
審査請求日	平成8年8月14日(1996.8.14)	(72)発明者	久志本 俊弘
審判番号	平10-19593		大阪市城東区今福南4丁目6番17-305
審判請求日	平成10年12月16日(1998.12.16)		号
		(72)発明者	岡本 種男
			大阪市東淀川区上新庄2丁目15番24号
		(72)発明者	藤通昭
			大阪府豊中市東豊中町5丁目2番103-
			105号
		(72)発明者	八百一億二
		1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,	大阪市都島区友渕町1丁目6番7-305
			号
			最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 光学材料用樹脂組成物および光学材料ならびに光学材料の製造法

1

#### (57)【特許請求の範囲】

【請求項1】 芳香族ジカルボン酸またはそのジエステル誘導体と一般式(1)で示されるジヒドロキシ化合物 および、炭素原子数が2から4の脂肪族グリコールからなり実質的に線状であって、一般式(1)で示されるジヒドロキシ化合物が樹脂中の全グリコール成分の10モル%以上95モル%以下であるボリエステル重合体であ\*

\* <u>り、</u>重合度が固有粘度にして0.3~0.8の範囲内のポリエステル重合体と、重合度が固有粘度にして0.2~0.7の範囲内の芳香族ポリカーボネートとを重量比5:95~90:10の範囲内のブレンド率でブレンドしてなる均一なブレンド混合物からなる光学材料用樹脂組成物。

【化1】

HO 
$$R_1$$
-O- $R_1$ -OH  $R_5$  (1)

3

(R,は炭素数2から4のアルキル基、R,、R,、R,およびR,は独立に水素または炭素数1から4のアルキル基)

【請求項2】 請求項1記載の樹脂組成物を成形してなる光学材料。

【請求項3】 請求項1記載の樹脂組成物を射出成形することを特徴とする光学材料の製造法。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光学材料用樹脂に関し、複屈折が小さく、透明性、耐湿性、機械的強度、寸法・形態安定性に優れ、特に、情報信号を盤上に記録し、再生するに好適で経済的な光ディスク基板用樹脂に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】レーザー光を用いて、ディスク基板上の 微細な信号を検出し、音声、画像、情報を記録・再生する光ディスクは、近年急速に用途が拡大している。この 光ディスク基板上の記録はサブミクロンの精度及びその 寸法安定性、更に保存安定性がよいこと等が必要である。また、光学特性として、基板の透明性がよいこと及び復屈折が小さいことが必要である。このためこれらの 製品はかなり高額なものとなっているのが現状である。【0003】従来、このような光ディスク基板としては、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリカーボネート(PC)、非晶性ポリオレフィン(APO)などの透明性ブラスチック材料が使用されている。また、特殊な芳香族ポリエステル共重合樹脂(特開昭57-208645号公報、特開平2-98845号公報、同2-38428号公報)が提案されている。

【0004】しかし、PMMAは光学特性の点では良い特性を示すが、吸湿性が大きくディスク基板が空気中の水分を吸収してソリがでやすく、寸法安定性がよくない上、耐熱性が乏しい欠点を有する。また、PCは吸湿性は低くソリは少ないが、流動性が悪く、成形性が困難という問題があり、かつ複屈折も不十分という欠点を有する。さらに、APOはすぐれた光学特性を有している \*

\*が、極めて高価である。

【0005】一方、芳香族ポリエステル共重合樹脂を提案した特開昭57-208645号公報、特開平2-98845号公報、同2-38428号公報によるものは、光学特性が不十分であったり、耐熱性が不足したり、高価な原料を用いたりして、必ずしも満足できるのではない。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、上述の 諸問題点に鑑み、透明性がよく、複屈折が小さくて、成 形性のよい、且つ耐熱性に優れ経済的に有利な光ディス ク基板を開発すべく鋭意研究を重ねた結果、特定の組成 を有するポリエステ<u>ル重</u>合体とポリカーボネートとの<u>均一な</u>ブレンド混合物を<u>成形</u>すると優れた光ディスク用基 板が得られることを見出し、本発明を完成したものであって、その目的とするところは、複屈折が小さく、透明性、耐湿性、機械的強度、寸法・形態安定性に優れ、耐熱性のよい光ディスク基板用樹脂を提供するにある。本 発明の他の目的並びに効果は以下の説明から明らかにさ れよう。

#### [0007]

【課題を解決するための手段】上記の目的は、芳香族ジカルボン酸またはそのジエステル誘導体と一般式(1)で示されるジヒドロキシ化合物および、炭素原子数が2から4の脂肪族グリコールからなり実質的に線状であって、一般式(1)で示されるジヒドロキシ化合物が樹脂中の全グリコール成分の10モル%以上95モル%以下であるボリエステル重合体であり、重合度が固有粘度にして0.3~0.8の範囲内のポリエステル重合体(第一成分)と、重合度が固有粘度にして0.2~0.7の範囲内の芳香族ポリカーボネート(第二成分)とを重量比5:95~90:10の範囲内のブレンド率でブレンドしてなる均一なブレンド混合物からなる光学材料用樹脂組成物及び光学材料ならびにその製造法により達成される。

[0008] [化2]

HOR<sub>1</sub>-O-R<sub>1</sub>·OH
$$R_3$$

$$R_4$$

$$R_5$$

$$R_5$$

$$R_5$$

$$R_5$$

$$R_5$$

【0009】上記のような2つの成分を<u>均一に</u>ブレンドして光学材料用樹脂を構成するが、このブレンドに用い

る芳香族ポリカーボネート (第二成分) の重合度は、固有粘度 (フェノール60重量%、1,1,2,2-テトラクロロエタン40重量%の混合溶液中、20℃で測定) にして0.2~0.7 <u>の範囲内である。すなわち、</u> この固有粘度が0.2未満の物はディスク基板に成形し

た時の機械的強度が不充分である。また、固有粘度が 0.7を超える物は、成形する際の流動性を低下させ、 分子配向しやすくなり、射出成形後、複屈折が大きくな る。従って、芳香族ポリカーボネート(第二成分)とし ては、重合度が固有粘度にして0.2~0.7の範囲内 のものを用い、好ましくは0.3~0.55の範囲内の ものを用いる。

【0010】また、上記ポリエステル重合体(第一成 分)の重合度は、固有粘度にして、0.3~0.8の範 囲内である。すなわち、この固有粘度が0.3未満の物 はディスク基板に成形した時の機械的強度が弱い。ま た、固有粘度が0.8を超える物は、成形する際の流動 性が低下し、サイクル特性を低下させ、成形品の複屈折 率が大きくなり易い。従って、ポリエステル重合体(第 一成分)としては重合度が固有粘度にして0.3~0. 8の範囲内のものを用い、好ましくは0.35~0.7 の範囲内のものを用いる。

【0011】本発明の樹脂組成物は、示差走査熱量測定 (DSC)を行ったとき、好ましくは単一のガラス転移 温度を与える。一般的には、ポリエステル重合体(第一 20 成分)と芳香族ポリカーボネート(第二成分)に対応す る二つのピーク、及び、それ以外のピークやショルダー を与える場合があるが、その多くは、透明性が悪く、熱 的に不安定で成形性も悪く、良好な光学材料とはなり難 44.

【0012】本発明の樹脂組成物のガラス転移温度は7 8℃以上、好ましくは80℃以上が必要である。ガラス 転移温度が78℃未満の場合は、例えば光ディスク製品 を保存中で基盤が変形し、ノイズ発生等の問題が生じ る。

【0013】本発明の光学材料用樹脂組成物は、上記の それぞれの重合度を持った2成分を均一にブレンドして 構成されるが、そのブレンド率はポリエステル重合体 (第一成分) と芳香族ポリカーボネート (第二成分) の 重量比で、5:95~90:10の範囲内とする。すな わち、ポリエステル重合体(第一成分)のブレンド率が この範囲未満では、複屈折率を低減させる効果が充分に 得られないからである。従って、ポリエステル重合体 (第一成分) と芳香族ポリカーボネート(第二成分) と <u>のブレンド率は、重量比で5:95~90:10の範囲</u> 40 内、好ましくは10:90~80:20の範囲内とす <u>る。</u>

【0014】本発明において、芳香族ジカルボン酸は、 テレフタル酸、イソフタル酸、ナフタレンジカルボン酸 等が挙げられるが、特にテレフタル酸が好ましい。 【0015】本発明において、一般式(1)で表される ジヒドロキシ化合物は、9、9-ビス-(4-ヒドロキ シエトキシフェニル) -フルオレン、9, 9-ビス-(4-ヒドロキシプロポキシフェニル)-フルオレン、

フルオレン等があるが、特に9、9-ビス-(4-ヒド ロキシエトキシフェニル) -フルオレンが好ましい。 【0016】9、9-ビス-(4-ヒドロキシエトキシ フェニル)-フルオレンは、例えば、9,9-ビスー . (4-ヒドロキシフェニル) -フルオレンにエチレンオ キサイド(以下、EO)を付加して得られる。この際、 フェノールの両水酸基にエチレンオキサイドが1分子づ つ付加した2m〇付加体(9,9-ピス-(4-ヒドロ キシエトキシフェニル)-フルオレン)の他に、さらに 数分子過剰に付加した、3 EO付加体、4 EO付加体等 の不純物が含まれる事がある。3 EO、4 EOなどの不 純物が多くなると、ポリエステル重合体の耐熱性を低下 させる事になる。このときの2 EO付加体の純度は85 %以上有れば良いが、好ましくは95%以上である。

【0017】9、9-ピス-(4-ヒドロキシプロポキ シフェニル) - フルオレン、9、9 - ピスー(4 - ヒド ロキシブトキシフェニル)-フルオレンは、例えば、 9, 9-ビスー(4-ヒドロキシフェニル)-フルオレ ンに各々、3-クロロープロパン-1-オール、4-ク ロロープロパンー1ーオールをアルカリ性条件下で反応 させれば得られる。この際の純度も、85%以上で有れ ば良く、好ましくは95%以上である。

【0018】本発明において、脂肪族グリコールとして は、エチレングリコール、1、3-プロパンジオール、 1,2-プロパンジオール、1,4-ブタンジオール、 1,2-ブタンジオール、1,3-ブタンジオールが挙 げられるが、中でもエチレングリコール、1,4-ブタ ンジオールが好ましく、特にエチレングリコールが好ま

【0019】本発明において、芳香族ポリカーボネート 30 としては、例えば芳香族ジオールとして2、2-ビスー (4'-ヒドロキシフェニル) プロパン (以下「ピスフ ェノールA」という)をホスゲンとアルカリ水溶液-塩 化メチレン系で界面重合させて得られるポリカーボネー トが上げられるが、その他の芳香族ジオールとして、例 えばビス-(4-ヒドロキシフェニル)メタン、1,1 -ビス-(4'-ヒドロキシフェニル)エタン、1,1 -ビス-(4'-ヒドロキシフェニル)プロパン、2, 2-ビス-(4'-ヒドロキシフェニル)ブタン、2, 2-ビス-(4'-ヒドロキシフェニル)ペンタン、 2, 2-ビス-(4'-ヒドロキシフェニル)イソペン タン、2,2-ビスー(4'-ヒドロキシフェニル)へ キサン、2、2-ビス-(4'-ヒドロキシフェニル) イソヘキサン、4,4'-ジヒドロキシトリフェニルメ タン、4,4'-ジヒドロキシテトラフェニルメタン、 1. 1-ビス-(4'-ヒドロキシフェニル)シクロへ キサン、2,2-ビスー(4'-ヒドロキシ-3'メチ ルフェニル)プロパン、2,2-ビス-(4'-ヒドロ キシー3',5'-ジメチルフェニル)プロパン、ジヒ 9, 9-ビス-(4-ヒドロキシブトキシフェニル)- 50 ドロキシジフェニルエーテル、ジヒドロキシジフェニル スルホン、ジヒドロキシジフェニルスルフィドといった、ビスフェノール類及びハイドロキノン、レゾルシン、o-メチルレゾルシン、o-クミルレゾルシンといった二価のフェノール化合物から選択される一種または二種以上を用いても良い。

【0020】上記2成分のブレンド方法としては、押し出し機、ニーダーなどによる溶融混練方法、あるいは上記2成分を例えば塩化メチレンなどの共通の良溶媒に溶解させた状態で混合する溶液ブレンド方法などがあるが、これは特に限定されるものではなく、通常用いられ 10るポリマーブレンド方法ならどのような方法を用いてもよい。

【0021】本発明において、芳香族ジカルボン酸またはそのジェステル誘導体と一般式(1)で示されるジヒドロキシ化合物と炭素原子数が2から4の脂肪族グリコールからなるポリエステル重合体(第一成分)は、例えば、エステル交換法、直接重合法等の溶融重合法、溶液重合法、界面重合法等の公知の方法から適宜の方法を選択して製造できる。またその際の重合触媒等の反応条件についても従来通りで良く、公知の方法を用いる事ができる。

【0022】本発明において、ポリエステル重合体(第一成分)は、溶融重合法を用いる場合に特に良好である。即ち、9、9ービスー(4ーヒドロキシエトキシフェニル)ーフルオレンの化合物は、末端基が脂肪族グルコールと良く似た性質であり、反応性が高い。これは9、9ービスー(4ーヒドロキシフェニル)ーフルオレンと比べると著しく異なるものである。この為に、酸クロリドという原料を用いる必要もなく、従って本質的に塩素が混入しない製造方法が可能であり、高温度での反30応条件で触媒使用量を少なくでき、残留異物が少ない方法が可能となった。

【0023】本発明において、ポリエステル重合体(第一成分)を溶融重合法のエステル交換法で製造するには、一般式(1)で表されるジヒドロキシ成分は樹脂中のグリコール成分の10から95モル%である。これが、95モル%より多くなると、溶融重合反応が進まなかったり、十分な重合度に達しない。

【0024】本発明において、ポリエステル重合体(第一成分)を製造する際に、溶液重合法、界面重合法等を採用する場合には、一般に酸成分の活性種として酸クロライドを用いたり、溶媒としてメチレンクロライド、クロロホルム等が使用するが、ポリマー中には副生成物である塩化物や触媒化合物が残留し、このものは一般的に製品の品質上良くないので、重合工程後に一般に残留異物を除去せねばならない。これらは、シート、フィルム、プレート、繊維等の成形工程での操業性を低下させ、得られる成形体の品質をも低下させる。例えば高温加熱時に熱分解が多量に発生する。

【0025】また、光ディスクや光磁気ディスク等の光 50 ック、ブレースケラー式コンペンセーターを装着し、5

学材料として本発明の樹脂組成物を使用する際は、反射膜や記録膜等の金属薄膜を基板に蒸着、スパッタリング等の方法で固着するが、基板内に残留塩素分があると、反射膜、記録膜を腐食し、光ディスクや光磁気ディスクの寿命や信頼性を低下させるので、十分な、洗浄、ろ過等の残留する塩素を除去する工程が必要となる。ポリエステル重合体(第一成分)の重合方法としては塩素が混入しないエステル交換法の方が好ましい。

【0026】光ディスク基板の成形には通常射出圧縮成形機がよく適合し、成形条件では、特に金型表面温度と樹脂温度が重要である。ジヒドロキシ成分の組成及び重合度などにより一概に規定できないが、金型表面温度は50℃以上160℃以下が好ましく、また、この時の樹脂温度は250℃以上350℃以下の場合には、樹脂の流動性と転写性が共に悪く、射出成形時に応力歪が残って、複屈折率が大きくなる傾向があり、また、成形サイクルも延びるので経済的でない。金型温度が160℃以上の場合には転写性は良いが、離型時に変形し易い。また、樹脂温度が350℃以上の場合は樹脂の分解が起こり易く、成形品の強度低下、着色の原因となるので好ましくない。

【0027】本発明の光学材料用樹脂組成物から光学材料を成形する場合には、原料の投入工程を始め、重合反応、共重合体を冷媒中に押し出してペレット状またはシート状にする工程では塵埃等が入り込まないように留意して行う事が望まれる。このクリーン度は、通常コンパクトディスク用の場合には1000以下であり、更に高度な情報記録用の場合には100以下である。

#### [0028]

【実施例】以下実施例を挙げて本発明を具体的に説明する。実施例中「部」とあるは重量部を、「%」は重量%を意味する。また実施例におけるポリマーの固有粘度、ガラス転移温度、複屈折率及び光透過率は次に示す測定法によって測定した。

【0029】(1)ポリマーの固有粘度 フェノール60重量%、1,1,2,2,-テトラクロロエタン40重量%の混合溶液50m1に共重合体0.15~0.5gを80℃で溶解後、20℃で粘度を測定し決定した。

## 【0030】(2)ガラス転移温度

示差走査熱量計(理学電気DSC-8230)を使い、あらかじめ約170°C、10分間熱処理した後急冷した 試料約10mgを用いて、10°C/minの昇温速度で加熱して測定した。JIS K 7121–1987°C定義されているようにして、ガラス転移温度Tmg、補外ガラス転移温度終了温度Tegを求めた。

【0031】(3) 複屈折率

カールツアイス社性偏光顕微鏡にて、セラルモン、ベレック ブレースケラーボコンペンセーターを装着し 5

46 nmの単色光で測定した。

【0032】(3-1)フィルムでの評価

樹脂をを260~300℃で溶融、押し出し成形で、直径30mm、厚さ1mmの円盤状の試験片を作製し、さらにその成形試験片を160~240℃でプレス成形し、厚み80~150μmのフィルムを得た。得られたフィルムを4×40mmの短冊状に切り出し、測定試験片を得た。補外ガラス転移終了温度 Teg+1℃の温度で測定試験片を10%/secで40%延伸後、急冷し、延伸フィルムを得た。これらのフィルムの複屈折率 10を測定した。

【0033】(3-2)ディスクでの評価 射出圧縮成形機にて成形した厚さ1.2mm、直径12 0mmのディスクの中心から半径方向50mmの位置の レターデーションを測定した。

【0034】(4)光透過率

ディスク基盤サンプルを用い、分光光度計にて波長500mmの光透過率を測定した。

【0035】(ポリエステル共重合体の調製)

(成分1-1)テレフタル酸ジメチル 38部、9,9 20 -ビス-(4-ヒドロキシエトキシフェニル)-フルオレン 35部、エチレングリコール 27部を原料とし、触媒として、酢酸カルシウム 0.042部を用い、これらを反応槽に投入し、攪拌しながら常法に従って190℃から230℃に徐々に加熱してエステル交換反応を行った。所定量のメタノールを系外へ抜き出した後、重合触媒である酸化ゲルマニウム 0.012部と、着色を防止するため、リン酸トリメチル 0.033部とを投入して、昇温と滅圧を徐々に行い、発生するエチレングリコールを抜きながら、加熱槽温度を280 30℃、真空度を1Torr以下に到達させる。この条件を維持し、粘度の上昇を待ち、2時間経過後反応を終了し、ポリエステル重合体を得た。

【0036】 このポリエステル重合体の固有粘度は0.55、ガラス転移温度は124℃であった。 1H-NMRスペクトルの測定により、このポリエステル重合体のテレフタル酸成分に対する9、9-ビス-(4-ヒドロキシエトキシフェニル)-フルオレン成分の割合は40

%であった。

【0037】(成分1-2)原料組成をテレフタル酸ジメチル 26部、9、9-ビス-(4-ヒドロキシエトキシフェニル)-フルオレン 56部、エチレングリコール 18部とし、酢酸カルシウムを0.028部、酸化ゲルマニウム 0.009部、リン酸トリメチル0.022部に変えた他は同様に工程を進行させて、ペレットを得た。

10

【0038】 このポリエステル重合体の固有粘度は0.51、ガラス転移温度は146℃であった。 1H-NMRスペクトルの測定により、このポリエステル重合体のテレフタル酸成分に対する9.9-ビス-(4-ヒドロキシエトキシフェニル)-フルオレン成分の割合は80%であった。

【0039】(成分2)市販の光ディスク用グレードの ビスフェノールAポリカーボネート樹脂を(成分2)と して用いた。この樹脂の固有粘度は0.43であった。 【0040】(実施例1)

成分 (1-1) と成分 (2) を30:70 (重合比)の割合で配合し、押し出し機を用いてベレットを作成した。この樹脂組成物の示差走査熱量測定 (DSC) の結果を図1に示す。単一のガラス転移温度、134.3℃であった。樹脂を290℃で射出成形して円盤状のサンブルを得た後、250℃でプレスし、厚さ130μのフィルムを得た。140℃で延伸を行うと複屈折率は41×10℃で射出成形して得られた試験片を使って求めた成形収縮率は0.69、曲げ弾性率は2.5×10℃、成形収縮率は0.69、曲げ弾性率は2.5×10℃、成形収縮率は0.69、曲げ弾性率は2.5×10℃、付上であった。同じ条件で射出成形したディスクのレターデーションは13nm、光透過率は90%であった。

成分 (1-1) と成分 (2) を50:50及び70:3 0 (重量比) の割合で配合し、押し出し機を用いてペレットを作成した。(実施例1) と同様に測定して得た結果を表1に示す。

[0042]

【表1】

	組成 (%)		ガラス転移温度 (℃)		復居折率	成形収縮	曲げ弾性率	レターデ ーション	光透過量
[	組成	組成	<u> </u>	1	(フィル	率 (%)	(10 <sup>4</sup> Kg	(ディス	(%)
	(+1)	(*2)	Tmg	Teg	᠘)		f/cn²)	ク) (nm)	
実施例1	40	.30	134	139 .	41×10 <sup>-4</sup>	0.69	2.5	13	90
実施例2	40	·50	129	134	28×10-4	D. 69	2.5	11	90
実施例3	40	70	126	130	18×10 <sup>-4</sup>	0.71	2. 2	9	90
実施例4	80	20	132	136	28×10-4	0.71	2.7	11	90
比較例1	-	0	140	147	168×10 <sup>-4</sup>	0.57°	2.7	30	90

(\*1) (第一成分)中の一般式(1)で表されるジヒドロキシ成分の割合。

(\*2) 樹脂組成物中の(第一成分)のブレンド率。

【0043】(実施例4)成分(1-2)と成分(2)を20:70(重量比)の割合で配合し、押し出し機を用いてペレットを作成した。(実施例1)と同様に測定して得た結果を表1に示す。

【0044】(比較例2)市販の光ディスク用グレードのポリカーボネート樹脂(成分2)を300℃で溶融成形して、円盤上のサンプルを得た後、240℃でプレスし、厚さ120μmのフィルムを得た。148℃で延伸を行うと複屈折率は168×10-4であった。

【0045】また、金型温度100℃、樹脂温度310 ℃で射出成形して得られた試験片を使って求めた成形収 縮率は0.57、曲げ弾性率は2.7\*10 Kgf/cm2で あった。同じ条件で射出成形したディスクのレターデー\* \*ションは30nm、光透過率は90%であった。

【0046】表1での比較から明かな様に、一般に用いられているポリカーボネート樹脂(比較例1)は光学異方性が大きいことが分かる。

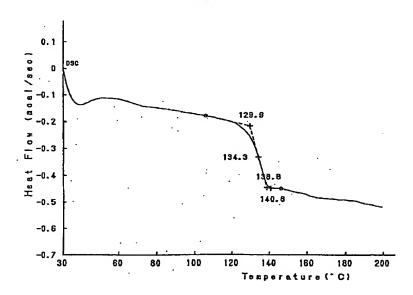
## 20 [0047]

【発明の効果】以上述べた如く、本発明の光学材料用樹脂組成物は、透明性、耐熱性が良く、成形性、寸法安定性、耐薬品性に優れた光学材料である。更に、この樹脂組成物からなる光ディスク基板は、光学的異方性が小さく産業的に有用なものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例1のDSC曲線。

【図1】



フロントページの続き

合議体

 審判長
 柿崎
 良男

 審判官
 小島
 隆

 審判官
 中島
 次一

(56)参考文献 特開 平6-49186 (JP, A)

特開 昭60-32698 (JP, A)